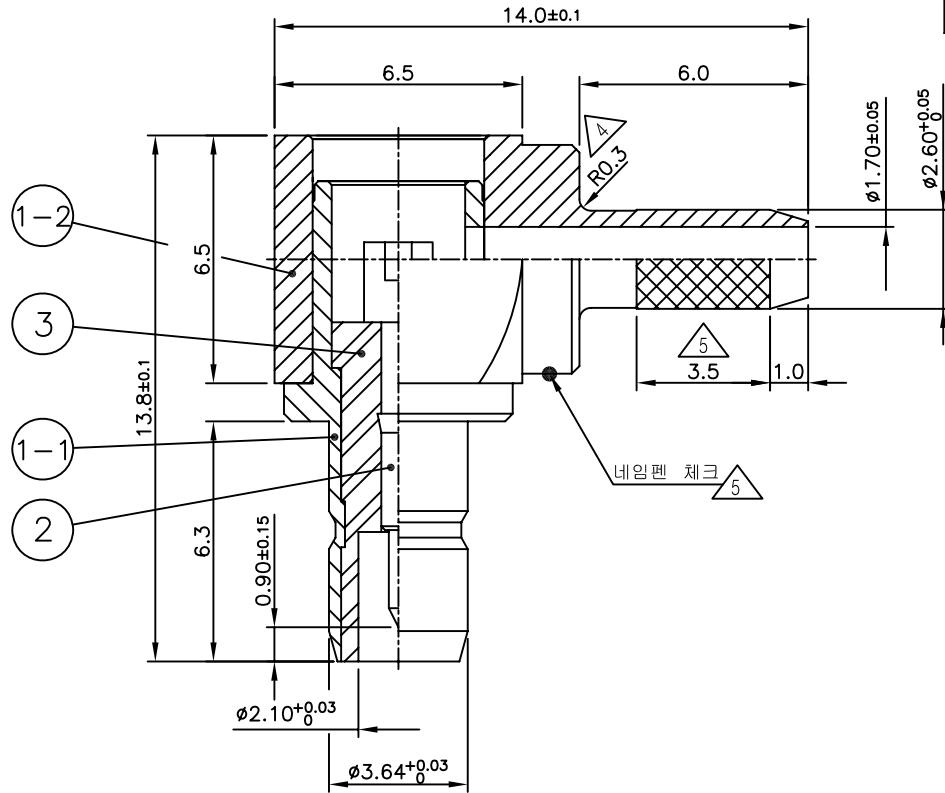




주 기

- 상대물과 삽입력과 이탈력 (상대물과 Mating 5회 이후 측정치)
 - 삽입력 : 2~4kgf
 - 이탈력 : 5~8kgf
- 상대물 Male Jack 내경 $\phi 3.44 \sim 3.45$ 관리
- 도금 사양
내장용(실내)
 - Nickel Plate : $5\mu\text{m}$ 이상 (BODY, JACK, COVER)
 - Gold Plate : $0.4\mu\text{m}$ 이상 (CONTACT)

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	I.C.KIM	I.H.YU	2004.12.10.
1	[설변No.연구2005-001] 메이팅 부분 변경 및 도금 두께 변경	I.C.KIM	I.H.YU	2005.01.12.
2	[설변No.연구2005-135] COVER 형태 변경 CHIP발생의 개선 사항으로 내부 턱 없앴	E.H.KIM	I.H.YU	2005.05.24.
3	[설변No.연구2005-151] 품번 4번 INSULATOR 삽입	C.L.CHOI	I.H.YU	2005.06.10.
4	[설변No.연구2005-211] 압체요구(널링 부위 간격 표준화, ROUND 추가)	E.H.KIM	C.L.CHOI	2005.09.05.
5	[설변No.연구200903-0019] 압체요구(BODY외부 네임펜 마킹)	E.H.KIM	S.J.YOUN	2009.03.12.
6	[설변No.연구200906-0003] 압체요구(FERRULE 삭제)	E.H.KIM	S.J.YOUN	2009.06.01.
7	[설변No.201310-0010] 압체요청 (COVER, 품번4번 INSULATOR BOM구성 삭제)	E.H.KIM	I.C.KIM	2013.10.22.

7 2	5	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5μm	DCO00020-5/1 (L3023)	
	7 3	4	INSULATOR	1	PTFE White	DIN00922-N/1 (H3143)	
		3	INSULATOR	1	PTFE White	DIN00298-N/2 (H3137)	
		6	3	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate DFE00034-5/1 (F3010)
1	2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate 0.4μm	DCT00393-5/1 (E3154)	
3 2 1	1	1-2	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5μm	DBB00218-5/1 DBD00455-3/1 (D3157B) DBD00480-3/1 (D3157A)
		1-1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5μm	
NO.		DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE	

TOLERANCE	Decimal ±0.1	DATE 2013. 10. 22.			 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	Angle ±1°	APPROVED BY	I.C.KIM				
MATERIAL	-	CHECKED BY	-	TITLE SMB50 CABLE JL RG316 (SMB A/G MALE)			
FINISH	-	DRAWN BY	E.H.KIM		A4	DWG NO.	CN00857-7/2
		SCALE 4/1	UNIT mm			REVISION	7